BroadCON-3D750

纳米银导电浆料（适合流体挤出式3D打印）

BroadTeko

产品概述

BroadCON-3D750是一款针对挤出式3D打印开发的纳米银导电油墨，该导电油墨浆料基于纳米银具有细度小、流变性优，可光固化、且与各种绝缘材料结合力强的特点，适合蠕动泵挤出头、螺杆泵挤出头、活塞针筒挤出、气动泵挤出头等多种挤出方式和直写方式，与3D打印绝缘材料结合，可以用于制造各种多层结构、异形结构、曲面结构、立体结构布线等特殊结构的电路板。

固化方式

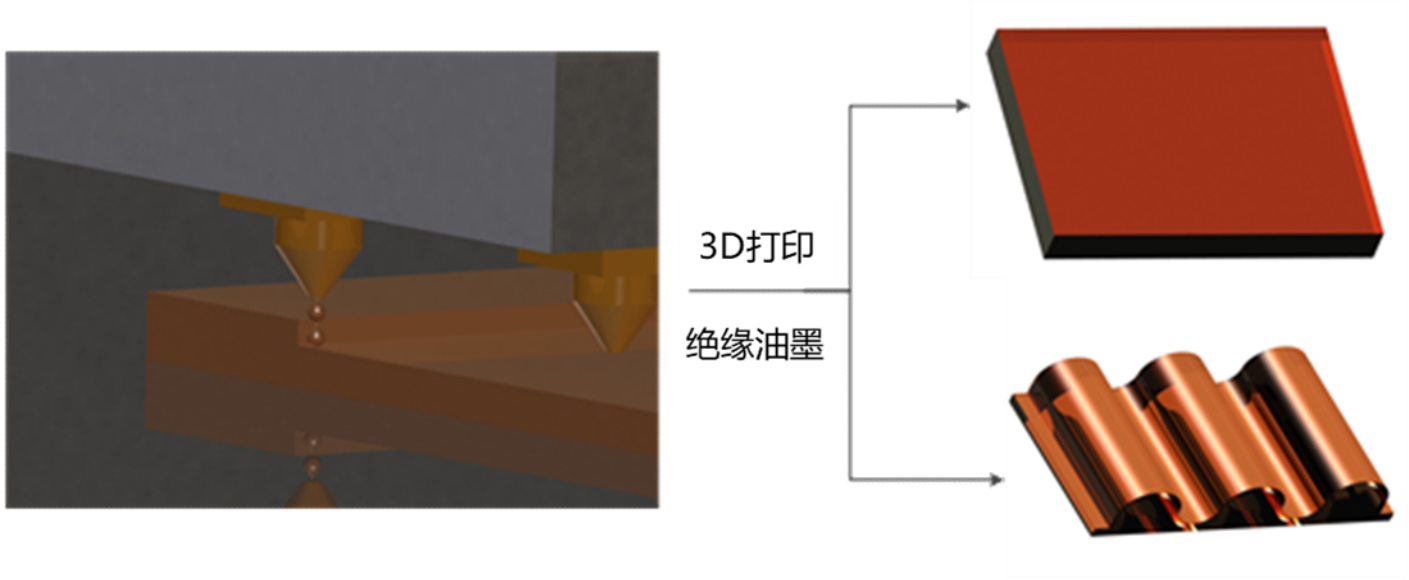
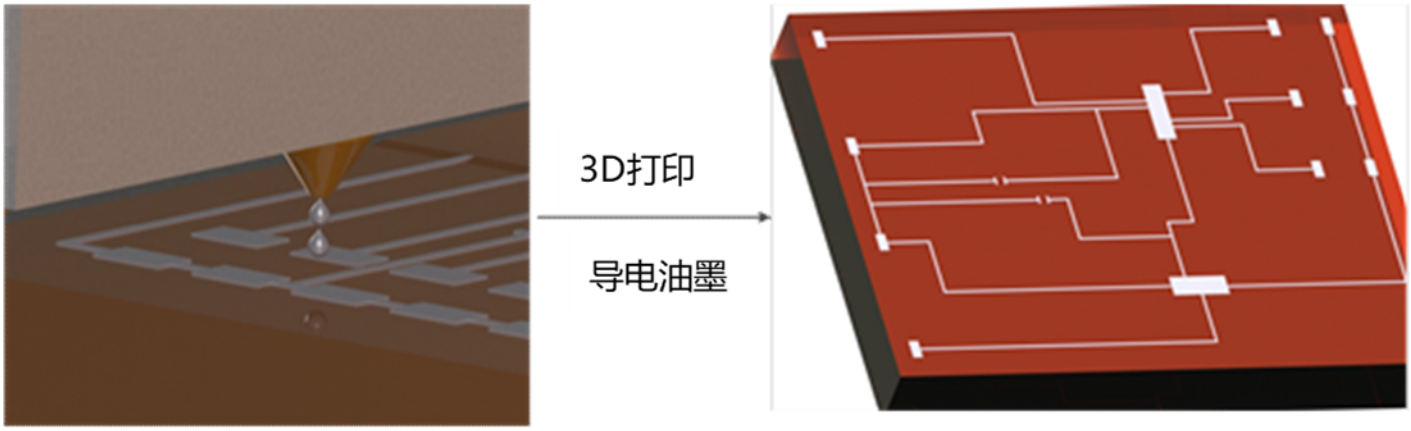
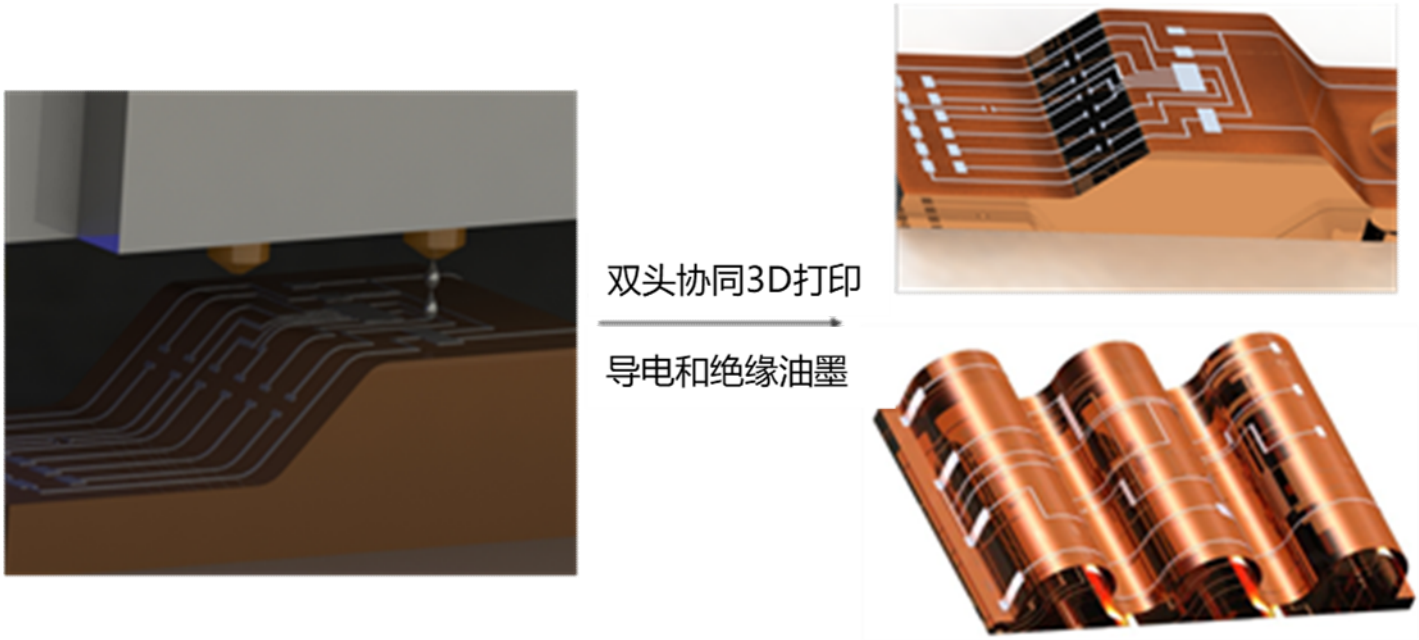
- 热固化
- 短波红外
- 808nm红外激光固化 （推荐）
- 1064nm红外激光固化（推荐）

挤出方式

- 活塞针筒挤出
- 螺杆挤出
- 蠕动泵挤出
- 气动泵挤出头
- 齿轮泵挤出
- 压电阀（PICO Pulse, Marco Vermes）

浆料参数

测试	性能指标
体系	绿色溶剂体系
银粉粒径	50nm
粘度（cp）	~2000cps 可调
银含量	75~80wt%
电阻率	（2~5）*$10^{-8}\Omega m$ 受固化条件影响
附着力	0级（100% 不脱落）
硬度	2H

BroadCON-3D750

纳米银导电浆料（适合流体挤出式3D打印）